

役立つ！ものづくり基盤技術・交流セミナー（第2回）

レーザー加工技術（切断，溶接，表面処理）

～ 基礎から応用まで ～

主催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、地方独立行政法人大阪産業技術研究所

開催日 令和元年 **9/25（水）**
 時間 **16:30～18:00**（セミナー） **18:00～19:00**（交流会）
 場所 **クリエイション・コア東大阪** 北館3階 309号室
 東大阪市荒本北1-4-17（近鉄けいはんな線「荒本駅」下車5分）



講師： 加工成形研究部 部長 萩野 秀樹

レーザーを用いた加工技術は、切断、溶接をはじめとして、穴あけ、焼入れ、クリーニング等様々な用途に用いられています。また加工対象も金属だけでなく、セラミックスや樹脂なども対象になっています。このように幅広く用いられている背景には、ファイバーレーザーをはじめ様々な種類のレーザーやレーザー加工周辺機器が次々に開発されていることが要因です。一方で、進歩の早い技術であることから、初めてレーザー加工設備を導入する場合、目的とする加工に適した装置を選択することは比較的困難です。本セミナーではレーザー加工（切断、溶接、表面処理）の基礎を紹介するとともに、様々な加工事例を紹介しながら、それぞれの加工に応じた装置についても、わかりやすく概説いたします。

講演は、基礎的な内容から最近の話題までお話ししますので、企業の製造現場の方、研究開発、営業技術、経営者に至るまで、幅広い方を対象としています。講師は交流会にも参加しますので人的ネットワークづくりにもお役立て下さい。

参加費無料（交流会は1,000円）

定員 30名（先着順）

ものづくり中小企業、支援機関

お申込み

「インターネット」または「FAX（下記の申込書に記載）」

※インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。

お問合せ先

大阪府ものづくり支援課（松尾・村上） **TEL：06（6210）9472**

CHECK!

MOBIO
<http://www.m-osaka.com>

から「MOBIO-Cafe 開催案内」をご覧ください。

参加申込書

FAX 06-6210-9505 ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままFAXして下さい。

参加者氏名		企業名 部署・役職	
電話番号		FAX番号	
E-Mail			
住所	〒		
交流会	<input type="checkbox"/> 参加する <input type="checkbox"/> 参加しない		

※ 交流会は18:00より、南館2階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費1,000円）

※ 本講習会参加申込みにかかる個人情報、主催者間で共有させていただきます。また、本申込書にご記入いただいた情報は、本講習会の参加者集計、その他催事情報提供などの案内を行う目的のみに使用します。